

Obchodné meno: edoma three s.r.o.  
Sídlo: Piešťanská 3, 91701 Trnava  
IČO: 47456264  
Telefón: 033-5533663  
Email: [info@edoma.sk](mailto:info@edoma.sk)

(ďalej len „Poskytovateľ“)

# TŠÚR

## **Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke**

**Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete Internet**

**Technické parametre ponúkaných účastníckych rozhraní**

Dátum vytvorenia: 1.6.2014

## 1. Úvod

V zmysle zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje „Poskytovateľ“ technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.

## 2. Predmet špecifikácie

„Poskytovateľ“ poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých „Poskytovateľ“ poskytuje prístup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

## 3. Koncový bod siete

V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:

**a)** rozhranie Ethernet podľa normy IEEE 802.3 [1] s prenosovou rýchlosťou 10, 100, resp. 1000 Mbit/s.

Rozhranie je elektrické, 8-vodičové metalické podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s, podľa 100BASE-T2 pre rýchlosti 100 Mbit/s a podľa 1000BASE-T pre rýchlosti 1000 Mbit/s. Vedenie je ukončené nerozoberateľným spojom s 8-vývodovým konektorom podľa IEC 60603-7 [2]. Koncový bod je ukončený koncovkou RJ45 alebo nástennou zásuvkou ( EN 50173 [3] ).K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3.

Vývod Popis okruhu

Vývod	Popis okruhu	Okruh
1	Transmitted data	TD+
2	Transmitted data	TD-
3	Received data	RD+
4		
5		
6	Received data	RD-

7		
8		

Rozhranie IEEE 802.3 - priradenie vývodov

**b)** - rozhranie Wireless LAN 2,4/5 GHz podľa normy IEEE 802.11, resp. IEEE 802.11b(g) [4] / IEEE 802.11a(n) [5]. K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11, IEEE 802.11b(g,n), resp. IEEE 802.11a(n). Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11, IEEE 802.11b a IEEE 802.11a. Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS, resp. OFDM. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.

#### 4. Skratky

IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov

10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

100BASE-T rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

1000BASE-T rozhranie 1000 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

DSSS Direct sequence spread spectrum

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

BNC Bayonet Concelman connector – konektor používaný pre pripájanie koaxiálnych káblov

#### 5. Odkazy na použité technické dokumenty

[1] IEEE Std 802.3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications, 8 march 2002

[2] IEC 60603-7: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards, Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality, 1990

[3] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes

[4] Standard IEEE 802.11b-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between

systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[5] Standard IEEE 802.11a-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 5 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.